



中华人民共和国国家标准

GB/T 12750—91

半导体集成电路分规范 (不包括混合电路)

Sectional specification for semiconductor integrated
circuits, excluding hybrid circuits
(可供认证用)

1991-03-21 发布

1991-11-01 实施

国家技术监督局 发布

中华人民共和国
国家标准
半导体集成电路分规范
(不包括混合电路)

GB/T 12750—91

*

中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街16号
邮政编码: 100045

<http://www.bzcbs.com>

电话: 63787337、63787447

1991年10月第一版 2004年12月电子版制作

*

书号: 155066·1-8304

版权专有 侵权必究

举报电话: (010) 68533533

中华人民共和国国家标准

半导体集成电路分规范(不包括混合电路)

GB/T 12750—91

Sectional specification for semiconductor integrated
circuits, excluding hybrid circuits
(可供认证用)

1 范围

本规范适用于已封装的半导体集成电路,包括多片集成电路,但不包括混合电路。

2 总则

本规范应与有关的总规范一起使用,并为评定包括数字、模拟及接口电路在内的半导体集成电路规定了质量评定程序、检验要求、筛选顺序、抽样要求、试验和测量程序的详细内容。

所有用确定工艺制造的器件允许应用“能力批准程序”(见 QC 001002《程序规则》11.7 条,但目前集成电路的“能力批准程序”尚在考虑之中)来代替“鉴定批准程序”。

如果需要且技术上可行,则对用上述确定工艺生产的任一型号或一组型号产品可以补充应用质量一致性检验规则(见 GB 4589.1《半导体集成电路总规范》3.6 条及本规范 5~9 章)。

本规范的所有要求在未被新条款“能力批准程序”(在考虑中)的要求修改前,将继续有效。

2.1 有关文件

GB 4589.1 半导体集成电路总规范

2.2 温度推荐值

见 IEC 748-1《半导体器件 集成电路第 1 部分 总则》第 VI 章第 5 条。

2.3 电压推荐值

见 IEC 748-1 第 VI 章第 6 条。

2.4 与制造过程有关的定义

2.4.1 生产线

生产线定义为有一套工艺操作(包括一个或多个下述制造阶段):

- a. 扩散;
- b. 芯片制备;
- c. 装配;
- d. 最终加工和最终电测量;

注:这些阶段不含质量评定程序。

(1) 扩散

该阶段为制造的初始阶段到划片前最后一道工序这一制造工艺操作过程。

(2) 芯片制备

该阶段为将晶片划分成芯片的制造工艺操作过程。就本规范而言,按制造厂情况,可将这一阶段划入扩散阶段或者装配阶段。

(3) 装配